

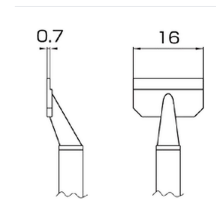
Composite-Entlötpitze SOP 16L - Hakko T16-1009

Artikel-Nr.	HK-T16-1009	Hersteller	Hakko
Hersteller-Nr.	T16-1009	EAN	4962615028137

Composite-Entlötpitze im Format SOP 16L für den Einsatz mit der Hakko FM 2022 Parallel-Entlötpinzette. Die Packung enthält 2 Ersatzspitzen für die effiziente Entnahme von Bauteilen auf SMD-Leiterplatten.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Überblick

Die Hakko T16-1009 ist eine Composite-Entlötpitze, die speziell für das Parallel-Entlötpinzettensystem FM 2022 entwickelt wurde. Im Format SOP 16L ausgeführt, ermöglicht diese Spitze das präzise und effiziente Entfernen oberflächenmontierter integrierter Schaltkreise und Bauteile von Leiterplatten, ohne umliegende Leiterbahnen oder Pads zu beschädigen.

Wesentliche Merkmale

- Format SOP 16L, optimiert für 16-polige Small-Outline-Gehäuse
- Composite-Aufbau für höhere Lebensdauer und bessere thermische Leistung

- Ausschließlich kompatibel mit der Hakko FM 2022 Parallel-Entlötpinzette
- 2er-Pack Ersatzspitzen für eine verlängerte Einsatzdauer
- Präzisionsgefertigte Geometrie für zuverlässigen Kontakt mit der Lötstelle
- Hergestellt in Japan nach den Qualitätsstandards von Hakko

Technische Daten

Spitzenformat	SOP 16L
Kompatibles System	FM 2022 Parallel-Entlötpinzette
Spitzenmaterial	Composite
Menge pro Packung	2 Stück
Herkunftsland	Japan

Anwendungen

Ideal für die Elektronikfertigung, das Rework von Leiterplatten, den Austausch von Bauteilen sowie präzise Entlötarbeiten in Labor- und Produktionsumgebungen. Besonders geeignet zum Entfernen oberflächenmontierter ICs und passiver Bauteile von dicht bestückten Leiterplatten.

Lieferumfang

- 2 × Composite-Entlötspitzen (Format SOP 16L)